



FOR IMMEDIATE RELEASE

**EV Group、オーストリア本社に新製造 V 棟(第 5 製造ライン)を竣工
生産能力を拡大**

*3D/ヘテロジニアス・インテグレーション市場の成長により市場拡大
EVG ハイブリッド接合やその他の主要プロセスソリューションへの強い需要に対応*

オーストリア ザンクト・フローリアン、2023 年 11 月 28 日 — MEMS、ナノテクノロジーデバイス、半導体製造向けウェーハ接合およびリソグラフィ装置のリーディングサプライヤーである EV Group (EVG) は、本社機能を置くオーストリア本社に、次の拡張段階に向けた建設工事が完了したことを本日発表しました。

EVG は、装置コンポーネントの製造部門として、新施設「マニュファクチャリング V」(第 5 製造ライン)を開設し、製造フロアと倉庫スペースを大幅に拡張しました。「マニュファクチャリング V」(第 5 製造ライン)は、急速に成長する先端パッケージングや 3D/ヘテロジニアス・インテグレーション市場をサポートする、EVG のハイブリッド接合およびその他のプロセスソリューションやプロセス開発サービスに対する継続した強い需要に後押しされ、一連の投資計画のうちの最新施設として新設されました。

今回、EVG の最先端施設「マニュファクチャリング V」(第 5 製造ライン)として増設されたのは、1,200 平方メートルを超える製造フロア(製造エリアとしては、合計 8,100 平方メートル超)と、1,200 平方メートルの倉庫スペースとなります。また、製造フロアの上階には新たに 2 フロアのオフィススペースも増床し、並行して、既存の「マニュファクチャリング II」棟(第 2 製造ライン)を、EVG の高精度システムの最終組み立ておよびテスト、そして顧客に立ち合いによる装置の出荷前検査のための 9 つの新しいテストルームとして改築しました。テストルームの面積を 30%増加したことにより、EVG 本社のテストルームの総面積は 2,800 平方メートルになりました。

EVG の「マニュファクチャリング V」(第 5 製造ライン)の開設は、同社が以前より継続して行う拡張投資計画の前フェーズ「マニュファクチャリング IV」(第 4 製造ライン)(昨年末に完了)に続くものであり、約 1800 平方メートルの生産スペースと倉庫スペースが追加されたものです。これら 2 つの増床計画に着手して以来、EVG は生産能力を 60% 以上向上しました。さらに EVG の拡張計画は次のフェーズに入っており、1,400 平方メートルの製造エリア面積と同程度の倉庫スペースを有する現在建設中の「マニュファクチャリング VI」(第 6 製造ライン)は、2024 年下半期に完成を予定しています。

EV Group のエグゼクティブ・オペレーション&ファイナンシャル・ディレクター兼エグゼクティブ・ボード・メンバーであるヴェルナー・タルナー博士は次のように述べています。「AI、ハイパフォーマンス・コンピューティング、自動運転など、半導体業界を活性化する新しいアプリケーションには、高度なパッケージングにおいて大規模なイノベーションが必要です。3D/ヘテロジニアス・インテグレーションの主要なプロセス実現要因として、フュージョン/ハイブリッド接合は、半導体製造の新しいスケールリングメカニズムへと変化しています。EVG は、現在、そして将来のお客様の生産能力向上と長期的な製品ロードマップをサポートするために必要なフュージョン/ハイブリッド接合やその他のプロセスソリューションの開発において最先端を走っています。長年にわたる当社製品に対する需要の伸びにより、EVG は進化するお客様のニーズに応えるため、EVG の製造能力とクリーンルーム能力を拡大するために大規模な投資を行ってきました。私たちはこの需要の伸びは今後数年間も続くと予想しています。」

EVGヘテロジニアス・インテグレーション ソリューション

EVG のウェーハ接合技術、リソグラフィ技術、計測ソリューションは、裏面照射型 CMOS イメージ センサーやその他の 3D-IC 積層デバイス、MEMS、化合物半導体などの先端パッケージングにおける技術革新の開発と大量生産を可能にします。3D デバイス集積のニーズに対応するハイブリッド接合や将来の 3D-IC パッケージング要件に対応するウェーハボンドアライメント技術、先端パッケージング用のガラス基板をなくし、薄層 3D 積層を可能にする IR レーザー剥離技術、ファンアウトウエハレベルパッケージング (FOWLP) 用のマスクレス露光、ウェーハレベルオプティクス (WLO) 製造をサポートする NIL およびレジスト処理における最近のブレイクスルーは、異種材料集積および、ウェーハレベルパッケージングにおける EVG のテクノロジーリーダーシップのほんの一例に過ぎません。

EV GROUP (EVG) について

EV Group (EVG) は半導体、MEMS、化合物半導体、パワーデバイスおよびナノテクノロジーデバイスの製造装置およびプロセスソリューションのリーディングサプライヤーです。主要製品には、ウェーハ接合、薄ウェーハプロセス、リソグラフィ/ナノインプリント・リソグラフィ (NIL) や計測機器だけでなく、フォトレジストコーター、クリーナー、検査装置などがあります。1980 年に設立された EVG は、グローバルなお客様および世界中のパートナーに対し緻密なネットワークでサービスとサポートを提供します。EVG に関する詳しい情報は www.evgroup.com/ja/ をご参照ください。

お問い合わせ先

イーヴィグループジャパン株式会社 マーケティング担当

TEL: 045-348-0665 E-mail: Marketing+CommunicationsJapan@EVGroup.com

Contacts:

Clemens Schütte
Director, Marketing and Communications
EV Group
Tel: +43 7712 5311 0
E-mail: Marketing@EVGroup.com

David Moreno
Principal
Open Sky Communications
Tel: +1.415.519.3915
E-mail: dmoreno@openskypr.com

###